

公司代码：688233

公司简称：神工股份

锦州神工半导体股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.85元（含税）。公司总股本170,305,736股，扣除回购专用账户635,016股，可参与利润分配股数169,670,720股，合计拟派发现金红利31,389,083.20元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.76%，2025年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动或实施股份回购，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本事项已获公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	神工股份	688233	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常亮	宋梦施
联系地址	辽宁省锦州市太和区中信路46号甲	辽宁省锦州市太和区中信路46号甲
电话	+86-416-711-9889	+86-416-711-9889
传真	+86-416-711-9889	+86-416-711-9889
电子信箱	info@thinkon-cn.com	info@thinkon-cn.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家植根中国本土市场的半导体材料和零部件公司，致力于中国集成电路制造核心工艺材料和零部件的国产化建设。目前公司大部分收入来自中国本土市场，已在供应链国产化方面取得长足进展。

报告期内，公司抓住下游市场机遇，严控成本、加强管理，营业收入增加，盈利能力进一步增强。公司的硅零部件产品，由大直径硅材料加工而成，其终端主要应用于存储芯片制造厂的等离子刻蚀工艺中，是需要定期更换的核心耗材。公司已在国产半导体供应链中占据了有利位置，受益于下游客户的国产化突破，硅零部件占公司总营收的比重已超过大直径硅材料，第二增长曲线进一步强化。

主要情况分别说明如下：

1、大直径硅材料

产品直径覆盖了从 14 英寸至 22 英寸所有规格，主要销售给中国、日本、韩国的下游客户，因此也可称之为“集成电路刻蚀用大直径硅材料”。该产品具有国际竞争力，在技术、品质、产能等方面处于世界领先水平。

报告期内，公司大直径硅材料产品生产情况稳定，产品结构继续优化升级，利润率较高的16英寸以上产品收入占比进一步提升，从2024年度的51.61%提升至2025年度的56.72%，毛利率为76.09%，对该业务的整体毛利率水平提高有较大贡献。

2、硅零部件

上述“大直径硅材料”，经过切片、磨片、腐蚀、打微孔、形状加工、抛光、清洗等一系列精密加工后，最终制做成等离子刻蚀机用硅零部件。公司是具备“从晶体生长到硅零部件成品”完整制造能力的一体化厂商，拥有全球领先的大直径硅材料晶体制造技术，是等离子刻蚀机设备厂家所需硅零部件产品的上游材料供应商。

报告期内，硅零部件产品实现收入23,717.16万元，同比增长100.15%。目前公司已取得了中国本土硅零部件市场的领先地位，已进入了中国主流存储芯片制造厂及等离子刻蚀设备制造厂的供应链，以高端品类为主，发挥了独特的国产化作用。

为保证未来客户批量订单的及时交付，公司子公司已经在泉州、锦州两地扩大生产规模，实现了较快速度的产能爬升。

3、半导体大尺寸硅片

公司以生产技术门槛高、市场容量比较大的轻掺低缺陷抛光硅片为目标，致力于满足该产品的国内需求。报告期内，半导体大尺寸硅片实现收入1,033.11万元。公司持续提升生产管理水平，通过优化排产计划及厉行节俭措施，在满足国内主流集成电路制造厂商验证需求的条件下，兼顾了经济效益，为未来更大规模供货打下良好基础。

2.2 主要经营模式

公司主营业务为大直径硅材料、硅零部件、半导体大尺寸硅片及其应用产品的研发、生产和销售，其采购、生产、销售模式如下：

1、采购模式

公司产品生产用原材料、包装材料根据“以产定购”的原则进行采购工作安排。

公司建立了供应商管理体系和供应商认证制度，根据供应商的资质条件、产品质量、供货能力、服务水平等情况对供应商进行综合评价，将符合条件的供应商纳入合格供应商清单。供应商进入清单后，公司会基于各部门的反馈以及市场调研情况，定期从产品质量和供货情况等方面对供应商进行持续评估和认证，根据评估结果调整采购订单的分配，并确保主要原材料有两家以上合格供应商具备供应能力。

2、生产模式

公司采取“客户订单+自主备货”的生产模式。公司根据客户发送的定制化产品订单情况组织采购和生产。此外，公司还会结合下游市场需求预测和与客户沟通情况统筹安排备货计划。

公司建立了《产品标识和可追溯管理规定》，每一件产成品均可以通过产品编号检索至单晶工艺跟踪单，从而获得产品的具体生产日期、质量检验员、生产班组等信息。产品质量的可追溯性为公司持续改进管理水平和生产工艺提供了重要保障。公司已经通过 ISO9001:2015 标准质量管理体系认证和 IATF16949: 2016 汽车行业质量管理体系认证。

3、销售模式

公司主要采用大客户直销的模式进行销售，营销部负责公司现有客户的维护和潜在客户的开发。客户发送订单至公司，经公司确认订单条款，双方对产品类型、数量、价格以及交货期等要素达成一致后按照订单约定履行各自义务。公司根据订单约定交付产品后，将持续跟踪客户产品到货情况及销售回款情况。

公司下游客户对大直径硅材料及其应用产品有较高质量要求，对供应商选择有较为严格的筛选、考核体系。公司成功进入下游客户供应链体系一般需要经历现场考察、送样检验、技术研讨、需求回馈、技术改进、小批试做、批量生产、售后服务评价等环节，认证过程严格，认证周期较长，一般为 3-12 个月不等。为了保证高品质产品的稳定供应，一旦通过下游客户的认证，客户会与供应商建立长期稳定的合作关系。

公司在拓展潜在客户时，会对客户进行背景调查，在对客户的技术要求进行内部评估的同时，对客户报价进行成本效益核算，进而对是否进入该潜在客户供应链体系进行综合判断。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业的发展阶段

经过半个多世纪的发展，“全球分工，自由贸易，效率优先”的国际半导体产业链已经发展成熟，分工严密且不断加深；但另一方面，近年国际政治经济局势的变化，也正在推动全世界主要经济体走向“芯片制造本土化”，各国竞相推出巨额补贴和政策支持，上马本土集成电路制造产能，全球集成电路制造产能的扩产规模和增速呈现加速态势。

SEMI 于 2025 年 10 月预测，从 2026 年至 2028 年，全球 300mm 晶圆厂设备支出预计将达到创纪录的 3,740 亿美元，2026 年投资将增长 9%，达到 1,160 亿美元；2027 年增长 4%，达到 1,200 亿美元；2028 年将增长 15%，达到 1,380 亿美元。其中，集成电路制造厂作为产业链核心企业，短期内大规模增加的资本开支，将为上游设备和材料厂商提供发展机遇。中国大陆预计将继续领

先全球，2026至2028年间在300mm晶圆厂设备的投资总额将达940亿美元。

报告期内，全球科技巨头对算力中心的单季度资本开支金额，已经从此前的300亿至400亿美元，大幅增加到800亿至1000亿美元的历史新高，并叠加消费电子产业链备料出货需求，因此存储芯片产能出现结构性短缺；中国本土存储芯片制造厂商发展迅猛，已经在前沿技术和市场份额两方面不断赶超海外竞争对手，改变了既有的全球产业格局；此外，消费者端侧应用创新正在加速，有望为半导体周期上行带来最根本且持久的市场驱动力。

公司处于行业上游的半导体硅材料行业及半导体零部件行业，深深植根于全球半导体产业链，还将伴随中国本土产业链发展而壮大。

（2）基本特点

半导体硅材料及半导体零部件行业有“三高”的特点：

1) 资金壁垒高

半导体级硅材料及半导体零部件行业同属于资金密集型行业，前期涉及厂房、设备等巨额资本投入，且生产所需高精度制造设备和质量检测设备的采购资金占比很高，固定资产投资规模庞大。同时规模化生产是行业参与者降低成本提升市场竞争力的必要手段，因此市场新进入者必须达到一定的经济规模，才能与现有企业在设备、技术、成本、人才等方面展开竞争。

2) 技术壁垒高

半导体级硅材料质量优劣的评价标准主要包括晶体尺寸、缺陷密度、元素含量、元素分布均匀性等一系列参数指标。实际生产过程中，除了热场设计、原材料高纯度化处理外，需要匹配各类参数并把握晶体成长窗口期以控制固液共存界面形状。在密闭高温腔体内进行原子有序排列并完成晶体生长是复杂的控制工程，工艺难度较高，且产品良品率和参数一致性受员工技能和生产设备性能的影响，人机协调也是工艺难点所在。

我国半导体级硅材料行业起步较晚，相比国外先进水平较为落后，具备相关理论知识和行业经验的高级技术人员以及熟练的技术工人都相对匮乏。市场新进入者难以在短时间内获得足够有丰富经验的专业性技术人员，而行业人才的培养、经验的积累以及高效的协作都需要较长时间。

半导体零部件行业，处于半导体制造设备行业的上游，行业内素有“一代工艺、一代材料（零部件）、一代设备”的规律。半导体零部件企业既需要衔接基础材料制备和集成电路制造前沿工艺，不断满足客户苛刻的质量要求并做出定制化改进，还需要具备规模化配套、稳定供应能力。我国半导体零部件企业往往处于加工环节，对上游原材料掌控力较低且难以获得集成电路制造的一线经验和数据，而制造过程中的“隐性知识”往往需要多年迭代才能日臻完善。因此，国内企业整

体上仍处于早期发展阶段，生产规模较小、良率较低，质量稳定性和一致性仍有待提高。

3) 市场壁垒高

半导体级硅材料行业及半导体零部件行业的下游客户为保证自身产品质量、生产规模和效率、供应链的安全性，十分注重供应商生产规模、质量控制与快速反应能力。因此，行业下游客户会对供应商执行严格的考察和全面认证程序，涉及技术评审、产品报价、样品检测、小批量试用、批量生产等多个阶段，行业下游客户确保供应商的研发能力、生产设备、工艺流程、管理水平、产品质量等都能达到认证要求后，才会考虑与其建立长期的合作关系。因此，认证周期较长，认证时间成本较高。一旦供应商进入客户供应链体系，基于保证产品质量的稳定性、控制供应商渠道开拓与维护成本等多方面的考虑，客户一般不会轻易改变已定型的产品供应结构。

(3) 主要技术门槛

1) 大直径硅材料晶体生长技术

公司大直径硅材料产品尺寸主要为 14-22 英寸，主要销售给半导体等离子刻蚀设备硅零部件制造商，经一系列精密的机械加工制作成为集成电路制造刻蚀环节所需的核心硅零部件。公司生产并销售的集成电路刻蚀用大直径硅材料纯度为 10 到 11 个 9，产品质量核心指标达到国际先进水平，可满足 7nm 及以下先进制程芯片刻蚀环节对硅材料的工艺要求。

公司凭借无磁场大直径单晶硅制造技术、固液共存界面控制技术、热场尺寸优化工艺等多项业内领先的工艺或技术，使公司能够实现不借助强磁场，仅在常规单晶生长设备上生长出大直径的单晶硅晶体，从而在维持较高良品率和参数一致性水平的基础上，有效降低了单位生产成本；公司顺应晶体“大型化”的市场趋势，引入了新型长晶设备，改良了热系统，提升生产过程数字化水平，提高了管理精细度，优化了工艺方案，实现了效能提升；大直径多晶硅材料及其制成品生产技术方面，公司研发团队攻关多晶硅晶体制造工艺，不断提升晶体良品率，能够满足客户对更大尺寸晶体的需求。

2) 硅零部件加工技术

大直径硅材料经过切片、研磨、钻孔、腐蚀、抛光、检验等多道精密加工步骤后，可制成等离子刻蚀机用的硅零部件，如：硅上电极、硅片托环等。等离子刻蚀机的气体通过气体分配盘，经由硅上电极的近千个细微小孔进入刻蚀机腔体中，在一定电压的作用下，形成高强度的等离子体。若细微小孔的孔径不一致，会影响到电路刻蚀的精度，从而造成芯片良率的下降；同时，上电极及硅片托环与芯片同处于刻蚀机腔体中，受等离子体的刻蚀后，逐渐变薄，当这些硅零部件厚度减少到一定程度后，需替换新的硅零部件，以满足等离子刻蚀机所需要的工艺条件。因此，

硅零部件是晶圆制造刻蚀工艺的核心耗材。硅零部件的物理特性和化学特性对于晶圆表面的沟槽精度、均匀性等指标有着重大影响。公司经过长时间的研发，掌握了硅零部件的全品类加工技术，在高深径比钻孔技术、表面处理技术、清洗技术等方面建立了坚实的技术基础。

3) 半导体大尺寸硅片行业技术

公司以生产技术门槛高，市场容量比较大的轻掺低缺陷抛光硅片为目标，目前从全球市场8英寸硅片总需求上看，轻掺硅片占全部需求的70%-80%左右。公司已掌握了包含8英寸半导体级硅片在内的晶体生长及硅片表面精密加工等多项核心技术。公司分阶段实施的工艺优化，即通过工艺和热场结构的变化，加强对晶体内氧含量的控制，以适配不同规格硅片的相应技术要求，能够实现从晶体生长端到硅片加工端的协同效应。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

在大直径硅材料领域，凭借多年的技术积累及市场开拓，公司在产品成本、良品率、参数一致性和产能规模等方面均具备较为明显的竞争优势，市场地位和市场影响力不断增强。目前公司已扎根于分工严密的国际半导体供应链中，大直径硅材料直接销售给日本、韩国等国的知名硅零部件厂商。后者的产品销售给国际知名刻蚀机设备厂商，例如美国泛林集团（Lam Research）和日本东电电子（Tokyo Electron Limited, TEL），并最终销售给三星和台积电等国际知名集成电路制造厂商。

随着集成电路制造产能向中国转移以及中国本土等离子刻蚀设备技术的突破，国内市场不断扩大，因此公司的大直径硅材料亦面向中国市场销售。公司产品质量稳定性高、交期及时，为国内集成电路制造产业国产化进程做出贡献。

报告期内，公司大直径硅材料产品生产情况稳定，产能得到稳健扩充；产品结构继续优化升级，利润率较高的16英寸以上产品收入占比上升至56.72%；成本方面，原始多晶硅原料价格已下降并稳定至历史价格中枢。公司持续成本节俭行动，继续保持行业内领先的毛利率，报告期内达到69.87%，较去年同期增加6.02个百分点，体现了公司的细分市场优势。

在硅零部件领域，目前公司已取得了中国本土硅零部件市场的领先地位，已进入了中国主流存储芯片制造厂及等离子刻蚀设备制造厂的供应链，以高端品类为主，发挥了独特的国产化作用。

随着中国本土集成电路制造产能的快速增加，以及国产等离子刻蚀设备原厂的技术进步和机台出货量增加。报告期内，公司主营业务收入中境内市场收入的占比为76.58%，公司硅零部件产品销售额同比增长100.15%，以上数据体现了公司在中国集成电路制造供应链国产化过程中的独特地位。

在半导体大尺寸硅片领域，公司核心技术团队在日本有多年的轻掺低缺陷硅片生产经验。公司是国内极少数专注于8英寸轻掺低缺陷技术路线的硅片厂商，具备替代海外供应商向国内集成电路制造厂商供应高质量硅片的潜在实力，有望在行业供求关系的变动中，发挥自身独特技术优势，优化变动成本，提升竞争地位。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 半导体市场结构性变化对产品定制研发和本土市场规模化配套能力提出更高要求

报告期内，全球半导体市场受到人工智能需求相关投资带动，呈现强劲复苏态势。SEMI认为，2025年全球半导体市场的增长来自前沿的逻辑芯片和代工、生成式人工智能、高性能计算等应用的增长以及芯片在终端领域的需求。

一方面，生成式人工智能应用快速迭代发展，算力相关存储、逻辑芯片热销；另一方面，尽管AI+PC、AI+手机的初代产品已经面世并引起广泛关注，AI Agent服务崭露头角，但消费电子市场能够取代“智能手机+APP”的下一代主机产品和服务的形态尚不明确。因此，下游市场的不确定性增加了上游企业对趋势的判断难度，同时也对企业的产品定制研发能力提出更高要求，唯有紧跟市场变化并推陈出新的企业才能快速反应、赢得先机。为此，行业龙头企业的业绩预测受到业界瞩目。

台积电预计2026年营收将以美元计算增长接近30%，显著高于全球晶圆代工产业14%的整体增速。台积电计划将2026年资本支出提升至520至560亿美元，较2025年的409亿美元增长27%至37%，重点投向先进制程产能扩张。台积电强调，尽管宏观经济存在不确定性，但AI需求依然强劲，产能持续紧张，未来三年资本支出将显著增加。

SK海力士预计2026年销售额将突破165万亿韩元，营业利润有望超过100万亿韩元，成为韩国首家达到这一里程碑的半导体企业，核心驱动力来自HBM（高带宽内存）市场的爆发式增长。该公司还预计存储芯片供应紧张局面将持续至2027年，推动价格全年上涨。为此，SK海力士计划将2026年资本支出增至30万亿韩元以上，重点投向清州M15X晶圆厂及龙仁半导体集群。

中芯国际预计2026年销售收入增幅将高于可比同业平均值，该公司管理层指出，产业链向本土化切换带来的重组效应将持续支撑2026年的收入增长，特别是在模拟类电路、显示驱动、图像传感器、存储及MCU等领域。

2025年下半年，国际领先的存储芯片制造厂商将既有产能用于人工智能所需的高端产品，乃至关停消费者级产品业务，导致消费者市场所需的存储芯片产能严重收缩，库存告罄，价格飙升。迫于以上成本压力，国内外个人电脑和智能手机等主机厂商将目光投向中国大陆供应链，叠

加中国人工智能算力建设所需，中国本土存储类集成电路制造厂商迎来难得的发展机遇。以上趋势有望成为全球芯片制造产能加速转向中国大陆的先声，将对半导体材料和半导体零部件厂商的定制研发能力和本土市场的规模化配套能力提出更高要求。

(2) 芯片制程日趋缩小对大直径硅材料和硅零部件制造技术提出更高要求

国际先进集成电路制造厂商的先进制程工艺正在持续进步：台积电预计 2026 年开始大规模生产 2nm 制程产品，1.4nm 制程产品预计 2027 年量产，1nm 制程产品预计 2028 年量产；三星电子计划 2026 年二季度量产 2nm 制程产品，持续优化 3nm 工艺；英特尔 2025 年启动 18A 制程风险试产，目标 2026 年量产，14A 制程产品计划 2027 年推出。

随着半导体加工制程不断进步，12 英寸集成电路产品的设计线宽越来越窄，因此沟槽也相应变窄，需要更高的刻蚀精度。更高的刻蚀精度，对硅片表面的温度、刻蚀气体浓度、材料性质提出更高的均匀性要求。采用更大的腔体和更大的上电极、下电极，更容易确保硅片面内各项工艺对均匀性的要求。因此，目前国际领先刻蚀机厂商的最新机型，都在向着大型化方向发展。随着以上技术工艺发展，更大尺寸的硅零部件及其所需的上游材料——更大直径的大直径硅材料(16 英寸以上)的需求也将随之增加。

此外，以 HBM 为代表的人工智能所需算力芯片研发竞争日趋激烈，SK Hynix、三星、美光都计划在 2026 年推出各自的新一代 HBM 产品。三维堆叠结构的 HBM 产品对 TSV 工艺提出更高要求，刻蚀工艺的精准控制和优化对于确保 TSV 的准确形成和可靠性至关重要，对刻蚀技术和刻蚀应用数量提出更高要求。

目前，公司 16 英寸以上大直径硅材料产品的技术和产能在全球市场拥有竞争优势；公司将持续研发针对体积较大、设计难度较高的 12 英寸高端制程所需硅零部件产品。

(3) 全球主要经济体芯片产业竞争所带来的风险与机遇并存

报告期内，美国对华技术出口管制政策频繁调整且充满不确定性。2025 年 1 月，美国政府发布《人工智能扩散框架》，拟进一步限制 AI 芯片出口。2025 年 5 月，美国政府撤销 AI 扩散规则，但发布指导意见加强管制。2025 年 8 月，BIS 将英特尔大连、三星中国公司、SK Hynix 中国公司从“经验证最终用户名单”移除，意图限制其产能升级和扩张。2025 年 12 月底，美国政府向三星、SK Hynix 颁发年度许可证，准许 2026 年向其中国工厂运送设备。

此外，美国、欧盟、韩国、日本都已在实施数十亿至数百亿美元不等的半导体投资补贴政策。宏大的发展目标及巨额的公共资金支持，正在改变全球半导体产业的资源流向和投资节奏。台积电在美国亚利桑那州投资 650 亿美元已完成建设两座晶圆厂，还在德国德累斯顿建设晶圆厂，计

划 2027 年量产；三星电子在美国德克萨斯州投资 370 亿美元建设两座先进逻辑晶圆厂，计划 2026 年投产；SK 海力士在美国印第安纳州投资 38.7 亿美元建设 HBM 先进封装厂和 AI 产品研发中心，计划 2028 年下半年投产。芯片制造产能对本土供应链的要求极高，并非仅凭政策和补贴能够一蹴而就，公司所在的东亚，中国、日本、韩国三国的产业链优势难以撼动。

全球主要经济体面向芯片制造领域的产业政策竞争持续加剧，带来的风险与机遇并存：一方面，公司的中国本土客户向美国及其盟国进口先进设备的难度大大增加，产品研发和产能扩张受到延缓和阻碍；另一方面，随着对华技术出口管制政策收紧，下游本土客户对国产供应商的评估认证积极性有所增强，速度有所提升，也为公司的硅零部件和半导体大尺寸硅片产品提供了更大的成长空间和更强的成长动能。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	2,083,316,926.92	1,992,903,335.46	4.54	1,933,422,436.15
归属于上市公司股东的净资产	1,890,097,190.33	1,792,961,454.97	5.42	1,761,794,579.03
营业收入	437,998,898.25	302,729,514.81	44.68	135,033,152.23
利润总额	124,984,134.10	52,527,554.47	137.94	-90,874,398.62
归属于上市公司股东的净利润	102,037,073.61	41,150,745.84	147.96	-69,109,826.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,322,432.25	38,343,442.86	161.64	-71,555,263.79
经营活动产生的现金流量净额	173,261,951.48	172,929,764.60	0.19	82,209,545.12
加权平均净资产收益率(%)	5.55	2.32	增加3.23个百分点	-4.31
基本每股收益(元/股)	0.60	0.24	150.00	-0.43
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.24	150.00	-0.43
研发投入占营业收入的比例(%)	7.63	8.26	减少0.63个百分点	16.64

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	105,844,314.91	102,683,378.88	107,472,139.40	121,999,065.06
归属于上市公司股东的净利润	28,510,674.09	20,327,254.57	22,331,646.38	30,867,498.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,754,046.41	21,235,862.55	21,764,623.53	30,567,899.76
经营活动产生的现金流量净额	45,759,150.71	21,748,284.44	58,523,882.32	47,230,634.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							16,132
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							18,301
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
矽康半导体科技 (上海)有限公司	0	35,550,301	20.87	0	无	0	境内非 国有法 人
更多亮照明有限公 司	-1,700,079	35,303,481	20.73	0	无	0	境外法 人
中信银行股份有限 公司—永赢先锋半	8,000,000	8,000,000	4.70	0	无	0	其他

导体智选混合型发起式证券投资基金							
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	2,879,812	2,879,812	1.69	0	无	0	其他
温州晶励企业管理合伙企业（有限合伙）	0	2,873,733	1.69	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	2,762,719	2,762,719	1.62	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	2,411,854	2,411,854	1.42	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	2,040,021	2,040,021	1.20	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华商均衡成长混合型证券投资基金	1,371,119	1,371,119	0.81	0	无	0	其他
广发证券股份有限公司—国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	856,060	1,180,137	0.69	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	矽康半导体科技（上海）有限公司、温州晶励企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区旭捷投资管理合伙企业（有限合伙）已签署一致行动协议。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

存托凭证持有人情况

适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入 43,799.89 万元，同比增长 44.68%；归属于上市公司股东的净利润 10,203.71 万元，同比增长 147.96%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用